

### 2-1-1-8 SR 気泡抱込／SR 吸附气泡／Air entrapped in solder resist

【特徴】SRの中に気泡が複数巻き込まれている状態の欠陥

【特征】在SR中吸附多个气泡的缺陷。

【Characteristics】More than one air bubble are entrapped in solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】SRインクの粘度不適や、印刷または塗布環境条件不適、印刷または塗布後から乾燥までの保留時間不足などにより出来たもの（SR印刷、塗布工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨粘度不合适，印刷或者涂布环境条件不合适，抑或印刷或者涂布后到烘干的停留时间不足所引起的（SR 印刷、涂布工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by use of improper solder resist ink viscosity improper and environmental condition for application, and insufficient holding time from application of ink to curing (Solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率×50

【注釋】显微镜倍率×50

【Comments】Magnification: ×50



【コメント】顕微鏡倍率×10

【注釋】显微镜倍率×10

【Comments】Magnification: ×10

### 2-1-1-9 全体的P SR 現像残り／整个板面的PSR 显影不净／Entirely underdeveloped photo solder resist

【特徴】P SR パターンコーナや、スルーホール内に、全体的にP SRが残っている状態の欠陥

【特征】整个板面在PSR图形的拐角，或者通孔内等残留PSR的缺陷。

【Characteristics】Photo solder resist left on all over the conductor edges or the inside of through holes

【原因・判断ポイント・発生工程】P SR 現像液の劣化や、現像速度が早過ぎたりして、P SR が除去しきれずに出来たもの（P SR 現像工程）

【原因、判断要点、发生工序】PSR 显影液变质或者显影速度太快，不能完全地除去PSR所造成的（PSR 显影工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by incomplete removal of photo solder resist due to a deteriorated develop solution or a too high developing conveyor speed (Photo solder resist development process)



【コメント】顕微鏡倍率×100

【注釋】显微镜倍率×100

【Comments】Magnification: ×100



【コメント】顕微鏡倍率×100

【注釋】显微镜倍率×100

【Comments】Magnification: ×100